산업통상자원부

보 도 자 료

2016년 10월 28일(금) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다.
(인터넷, 방송, 통신은 10.27(목) 오후 17시30분 이후 보도 가능)

배포일시	2016. 10. 27. (목)	담당부서	전자부품과
담당과장	안세진 과장 (044-203-4270)	담 당 자	전동욱 서기관(044-203-4271)

미래 반도체 생태계 강화를 위한 협업 다짐

- 제9회 반도체의 날 기념식 및 반도체 희망펀드 협약식 개최 -

□ '16.10.27.(목) 반도체의 산·학·연 관계자들이 **'제9회 반도체의 날' 행사**에 모여, 최대 수출품목으로서의 성과를 축하하고, 끊임없는 도전과 기술혁신을 통해 녹록치 않은 대내외 상황을 극복하자는 결의를 다졌다.

* 일시 / 장소: '16.10.27(목) 18:00 ~ 20:00 / 서울 코엑스 인터콘티넨탈 호텔

○ '반도체의 날'은 반도체 수출이 최초로 100억 달러를 돌파한 1994년 10월을 기념해 2008년부터 개최했으며,

○ 9회째를 맞는 이날 기념식에는 **주형환 산업통상자원부 장관,** 박성욱 한국 반도체산업협회장(SK하이닉스 사장), 전영현 삼성전자 사장 등 산·학·연 관계자 450여명이 참석했다.

□ 특히, 이날 반도체의 날 행사에서는 삼성전자, 에스케이(SK)하이닉스, 한국산업은행, 한국성장금융 간에 한국 반도체산업 생태계 강화를 위한 **'반도체 희망펀드' 투자협약 양해각서(MOU) 서명식을 가졌다.**

○ '반도체 희망펀드'는 상대적으로 취약한 국내 반도체 산업 생태계 발전을 위하여 **팹리스(설계 전문), 장비·소재 기업**에 주로 투자하는 전용 펀드로,

- **삼성전자가 500억 원, 에스케이(SK)하이닉스가 250억 원 을 자발적으로 출자**하고, 정책금융기관 및 투자자 매칭을 받아 **2,000억 원을 목표**로 조성할 계획이다.

○ 이 펀드는 주 목적인 반도체 기업에 **65% 이상을 투자**하는 것을 목표로 하고 있다.

- 출자기관(삼성전자, SK하이닉스), 반도체 전문가 등이 **자문단을 구성**하여 유망기업 발굴, 수요처 연계, 추가 투자 유치 등 투자 기업의 성장을 위한 자문 기능도 수행할 계획이다.

○ 또한, **소프트뱅크**는 반도체 펀드가 투자하는 기업의 발전을 위해 **후속 투자와 해외 진출을 지원하고, 기업 발굴과 평가**에도 적극 참여하기로 했다.

* 지난 9월 방한한 손정의 소프트뱅크 회장은 한국에 향후 10년간 5조원을 목표로 투자하겠다는 뜻을 밝혔고, 소프트뱅크벤처스코리아는 현재 운용 중인 SB글로벌스타펀드(1,200억원 규모) 및 추가 결성 중인 펀드를 통하여 반도체 분야에 적극 투자할 계획

□ **주형환 장관은 축사**를 통해 2년 연속 수출 600억불을 달성한 우리 반도체 산업의 성과를 치하하고, 산업의 생태계를 강화하기 위한 **민간의 자발적인 펀드 조성을 높이 평가**했다.

○ 특히, **제4차 산업혁명의 도래**에 따라 인공지능·사물인터넷(IoT)·가상현실 기술이 폭발적으로 발전할 것으로 예상되고, 그 핵심부품인 반도체 산업에 새로운 기회가 펼쳐지고 있는 상황에서,

○ **국내 대기업이 자발적으로 조성한 반도체 희망펀드**가 시스템 반도체 기업의 창업과 성장을 촉진하는 토양이 되어, 산업 생태계 조성의 촉매제 역할을 할 수 있을 것으로 기대감을 보였다.

○ 또한, 정부도 민간의 선도적 투자를 지원하고, 미래지향적 연구개발(R&D) 사업으로 생태계 저변을 강화하는데 정책적 노력을 더욱 기울이겠다고 약속했다.

□ 아울러, 반도체의 날을 맞아 우리나라 반도체산업 발전에 공적을 남긴 **유공자 41명에 대한 정부 포상**도 있었다.

○ **은탑산업훈장**은 세계 최초 10나노급 디(D)램과 4세대 적층 낸드플래시 메모리 개발, 10나노 로직공정을 개발한 공로로 **삼성전자의 정은승 부사장**에게 수여되었고,

○ 세정/코팅 원천기술 확보하여 국내 최초 반도체 제조용 핵심부분품 국산화에 성공한 **(주)미코의 전선규 대표이사가 동탑산업훈장**, 세계 최초 수직적층(TSV) 기술 기반 초고속 메모리반도체(HBM) 개발에 기여한 **SK하이닉스의 전준현 상무가 산업포장**을 받았다.

○ 이 밖에도 대통령 표창 2명, 국무총리 표창 3명, 산업통상자원부장관 표창 33명에게 포상을 수여했다.

< 반도체 산업발전 정부포상 대상자 >

구 분	훈 격		규모	비 고
정부 포상 (41점)	산업 훈장	은탑	1	정은승 부사장(삼성전자)
		동탑	1	전선규 대표이사((주)미코)
	산업포장		1	전준현 상무(SK하이닉스)
	대통령표창		2	염근영 교수(성균관대), 송윤석 대표이사((주)티엘아이)
	국무총리표창		3	박종흥 전무(SK머티어리얼즈), 정헌준 대표이사(클레이픽셀), 명재민 교수(연세대)
	장관표창		33	박준규 대표((주)이구루) 등 33명

<별첨 1> 제9회 「반도체의 날」 기념식 개요

<별첨 2> 정부포상 수상자 명단

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 산업통상자원부 전자부품과 안세진 과장(☎ 044-203-4270), 전동욱 서기관(☎ 4271)에게 연락주시기 바랍니다.

참고 1 **제9회 반도체의 날 기념식 개요**

1. 추진 배경

○ 2008년부터 **10월 넷째주 목요일을 『반도체의 날』로 제정**하고, 반도체 산업 경쟁력 강화에 크게 이바지한 **유공자 및 공로자에 대한 포상 및 노고를 격려하는 기념식 개최**

* '16년 포상 수여규모 : (훈장)2, (포장)1, (대표)2, (국표)3, (장관)33 등 총 41점

2. 행사 개요(안)

○ 개최일시 : 2016년 10월 27일(목), 18:00 ~ 20:00

○ 행사장소 : 코엑스 인터컨티넨탈 호텔 하모니볼룸(B1)

○ 초청인사 : 산업부 장관, 협회장 및 업계 CEO, 업계원로, 반도체 산업 유공자 등 450여명

3. 행사 일정(안)

시 간	세 부 사 항	비 고
17:20~18:00	**【식전행사】 VIP 환담 및 기념촬영**	**VIP룸(B1, 모데라토)**
18:00~18:50	**【1부】 기념행사**	**하모니볼룸(B1)**
18:00~18:02 (2')	- Opening 영상	-
18:02~18:03 (1')	- 개식 선언	사회자 (서현진 아나운서)
18:03~18:05 (2')	- 국민의례	
18:05~18:08 (3')	- VIP 소개	
18:08~18:13 (5')	- 환영사	협회장(박성욱 사장)
18:13~18:33 (20')	- **유공자 포상(정부 41점))** * 은탑훈장(1), 동탑훈장(1), 산업포장(1), 대통령 표창(2), 국무총리 표창(3), 산업부장관 표창(33)	**산업부** **소재부품정책관**
	- 유공자 포상(민간 20점)	협회장
18:33~18:43 (10')	- **반도체펀드 조성 협약식**	**산업부장관,** 기업대표
18:43~18:48 (5')	**- 축사**	**산업부장관**
18:50~20:00	【2부】 축하공연(만찬)	
18:50~19:00 (10')	- 축하공연 및 만찬개시	반도체고등학교 합창단
19:00~19:02 (2')	만찬 - 건배 제의	주요VIP
19:25~19:30 (5')	만찬 - 경품 추첨	주요VIP
19:30~ (30')	만찬 - 수상자 기념 촬영	
19:50~ (10')	만찬 - 폐회	

참고 2 반도체의 날 정부 포상자 명단

□ **정부 포상** : 훈장(은탑1, 동탑1), 산업포장(1), 대통령표창(2), 국무총리표창(3), 산업부장관표창(33) 등 총 41점

훈격	소 속 직 급	성명	주요 공적
산업훈장 (은탑)	삼성전자 부사장	정은승	▪ 세계 최초 10나노급 D램, 4세대 적층 낸드플래시 메모리 개발, 10나노 로직공정 개발(16년) ▪ 반도체 수출 확대('12년 240만불→ '15년 383만불(60% 향상)
산업훈장 (동탑)	㈜미코 대표이사	전선규	▪ 국내 최초 반도체 제조용 핵심부분품 국산화 개발 - 세정/코팅 원천기술 확보, 약 10.3조원 원가절감('01～'15)
산업포장	SK하이닉스 상무	전준현	▪ 세계 최초 TSV 기술 기반 초고속 메모리반도체(HBM) 개발 - 국내/외 특허 236건, 논문 6건 등록
대통령표창	성균관대 교수	염근영	▪ 반도체산업 원천기술 상용화 기여 - 중성빔 이용 원자층 식각기술 개발, 수입대체 4,000억원 ▪ 반도체분야 고급인력 양성 기여(박사 29명, 석사 71명)
	㈜티엘아이 대표이사	송윤석	▪ 세계 최초 디스플레이용 반도체 Timimg Controller 개발 - 누적 출하량 : 5억2천9백만개, 매출액 883억원
국무총리표창	SK머티리얼즈 전무	박종흥	▪ 반도체 제조용 특수가스 국산화 성공 - 삼불화질소 세계시장 점유율 40% 달성
	클레어픽셀㈜ 대표이사	정헌준	▪ 국내 최초 광대역 보정기능용 시스템반도체 국산화 성공 - 보안감시 및 차량용 시스템반도체 설계 전문
	연세대 교수	명재민	▪ 반도체 소재산업 세계 최고 수준의 기술경쟁력 제고 - EUV용 Blank Mask, CMP용 슬러리, TSV용 NCF 연구개발을 통한 국내 반도체 소재분야 기술 경쟁력 제고